



3D・チップレット研究会第3回公開研究会

主催:システムインテグレーション実装技術委員会
協賛:応用物理学会 シリコンテクノロジー分科会、3Dヘテロ集積アライアンス(3DHI)、
日本半導体製造装置協会(SEAJ)、日本電子回路工業会(JPCA)、SEMIジャパン

◆公開研究会のご案内

1つのチップにすべての機能を収納するSoCの時代から、機能ごとにチップを製造し、これらをインテグレーションするチップレット集積の時代への移行が始まっています。チップレットには様々な実装構造が議論されており、さらには3DIC(3次元集積化デバイス)も合わせて議論されています。チップレットおよび3DICの各種構造に関わる、チップ実装技術、RDL及びインターポーザを含む相互接続技術、パッケージング技術などを、製造技術だけでなく、材料技術や設計評価技術を含み、サプライチェーン/エコシステムも考慮して、課題や将来必要となる技術を議論していきたいと考えております。

今回は、3D・チップレット実装に関わる実際の先端技術開発とその動向の第3回目となりますが、特にチップレット化で重要となる、設計技術、テスト技術にもフォーカスし、皆様と一緒に技術課題や方向性を考えてみたいと思います。皆様方の積極的なご参加をお待ちしています。

テーマ：『 2.xDおよび3D実装技術の最新開発動向(その3) 』

開催日時 2023年5月11日(木) 13:00~17:30(予定)

開催方式 会場現地とオンラインのハイブリッド

開催場所 ①新川崎創造のもり・AIRBIC(先着250名様まで)

川崎市幸区新川崎7-7(JR横須賀線新川崎駅徒歩10分・JR南武線鹿島田駅徒歩15分)

<https://kawasaki-sozonomori.jp/airbic/>

②Zoom Webinar(先着300名様まで)

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します

◆プログラム

13:00~13:50

「再び挑む、最先端半導体パッケージ開発の舞台」

Rapidus株式会社 専務執行役員 折井 靖光 氏 (3D・チップレット研究会主査)

13:50~14:40

「ドメイン・スペシフィック・アクセラータの初期コスト削減を目指すマルチIPチッププロジェクト」

産業技術総合研究所 産総研・東大AIDL ラボチーム長 大内 真一 氏

(休憩10分)

<次頁につづく>

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

(つづき)

14:50～15:40

「WOW/COWハイブリットBBCube大規模集積システム」

東京工業大学 未来産業技術研究所 特任教授 大場 隆之 先生 (WOW Alliance)

15:40～16:30

「パッケージ内部構造の微細化に対応した樹脂材料の研磨とVUV処理による密着性改善」

大阪公立大学 工学研究科 教授 齊藤 文靖 先生 (半導体超加工・集積化技術研究所長)

16:30～17:20

「3D・チップレット実装のテストと評価 -DFT規格IEEE1838とアナログバウダリスキャン-」

愛媛大学 亀山 修一 先生 (バウダリスキャン研究会主査)

17:20～17:30

「APCS2022結果報告と次回開催について」

SEMIジャパン

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

参加要項

定員 会場① 250名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)
会場② 300名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員:3,000円、学生会員:1,000円、研究会会員:別払い、シニア会員:2,000円

名誉会員:無料、賛助会員の社員:3,000円、賛助会員(クーポン利用):無料

非会員一般:10,000円 非会員学生:2,000円 協賛団体会員:3,000円

注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
- ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
(お支払い方法:銀行振込・クレジットカード決済)
- ③請求書や振込確認後の領収書のご発行は、返信メールのマイページから出力が可能です。
- ④WEBの請求書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
- ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。
*キャンセルポリシー
お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

①現地参加の方
会員/賛助/非会員

②WEB参加の方
会員/賛助/非会員

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会

講演資料、講演内容、研究会についての問い合わせ:<https://forms.gle/yE8dNWNYNvmubBXB8>
お申し込みについての問い合わせ:info@jiep.or.jp (メールアドレスは¥を@に置き換えてください)